

※本リリースは鉄鋼研究会へ配布しております。

2026年4月28日

株式会社田中貴金属グループ

田中貴金属、SEMICON Southeast Asia 2026に出展

**～ASEAN地域における持続可能な半導体製造を支える貴金属材料と
循環型ソリューションを紹介～**

田中貴金属の産業用貴金属事業を展開する田中貴金属工業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：田中 浩一郎）は、**2026年5月5日（火）から7日（木）まで、マレーシア・クアラルンプールのMalaysia International Trade & Exhibition Centre（MITEC）で開催される国際展示会「SEMICON Southeast Asia 2026」（ブース番号：1521）に出展いたします。**

本展示会では、**半導体製造の前工程やパッケージング・テスト工程を支える貴金属素材および関連技術を包括的に紹介**します。代表的な製品・技術として、ボンディングワイヤ、銀（Ag）接着剤、AgSn TLPシート、スパッタリングターゲット、プローブピン、各種めっき技術、貴金属回収・精製技術などが含まれます。これらの製品・技術は、次世代半導体およびパワーエレクトロニクス分野の高度化に貢献するとともに、貴金属の循環利用を推進します。

■ASEANにおける半導体事業および循環型経済への取り組みを強化

田中貴金属は、**1960年代からパッケージング材料の開発・製造を手がけ**、ASEANでは、1978年設立の**田中エレクトロニクス シンガポール(PTE.) LTD.**および、1994年設立の**田中エレクトロニクス (マレーシア) SDN. BHD.**を製造拠点として擁しています。マレーシアおよびASEANにおいて、およそ50年にわたり、製品提供と技術サポートの実績を重ね、顧客の信頼を確立してきました。

田中貴金属は現在、パッケージングおよびテスト用途に加え、前工程プロセスにおいても、最先端の半導体製造に不可欠な高純度材料や独自組成の合金材料などの開発・供給を行っています。

さらに、長年にわたり培ったリサイクル技術を活かし、貴金属の回収・精製から、リサイクル由来の貴金属を用いた製品製造までを一貫して提供する、**ワンストップ循環型ソリューション**を展開しています。お客様との連携を通じて、半導体製造における貴金属の循環利用を推進し、環境負荷の低減やカーボンオフセット、資源利用の効率化に貢献しています。また、グローバルでのリサイクル体制の強化と、マレーシアおよびASEAN地域における持続可能な半導体エコシステムの構築を支援しています。

【半導体用途向け貴金属材料】

● ボンディングワイヤ

半導体チップと外部回路を電氣的に接続する金属接合材料として、金 (Au)、銀 (Ag)、銅 (Cu)、パラジウム被覆銅 (PCC) の極細線に加え、パワーデバイス用途向けにはアルミニウム (Al) と Cuの太線やリボンを提供しています。これらの材料は、表面品質および寸法安定性を管理して製造されており、金属接合に関する技術的知見とともに提供されます。

● 銀 (Ag) 接着剤

銀 (Ag) 接着剤は、シリコン (Si) に加え、シリコンカーバイド (SiC) や窒化ガリウム (GaN) などの次世代半導体にも対応する導電性ダイアタッチ材料です。高い熱伝導性と信頼性を両立する材料をラインアップしており、200 W/m・Kを超える熱伝導率を有します。

● AgSn TLPシート

最大20mmの大型チップサイズに対応可能なパワー半導体向けシート状接合材料であり、大面積においても信頼性の高い接合が可能です。EV、HV、産業インフラなどの高電流用途に対応し、様々な基板に対して最大50MPaの接合強度を達成するとともに、鉛フリー材料です。

● スパッタリングターゲット

半導体、電子部品、ハードディスクドライブなどの用途向けに、貴金属スパッタリングターゲットを提供しています。高純度・合金化技術、原材料調達における厳格なコンプライアンス、柔軟な供給体制、充実した技術サポートを強みとしています。お客様の多様なニーズに対応するため、研究開発にも積極的に取り組んでいます。

● プローブピン材料

半導体検査用プローブピン向けに、高導電性かつ耐摩耗性に優れた材料を提供しており、微細ピッチ用途やカスタム仕様にも対応しています。パラジウム (Pd) 合金、銅 (Cu) 合金、イリジウム (Ir)、ロジウム (Rh) などを含む幅広いラインアップにより、機械的特性および電気特性のさまざまな要求に応えます。耐久性向上のニーズの高まりに対応し、従来のPd合金を上回る硬さ640HVを実現した独自材料「TK-SK」に加え、高強度と高導電性を兼ね備えたRh系材料「TK-SR」も開発し、前工程プローブカード用途に対応しています。

● めっき技術および装置

半導体部品をはじめとするさまざまな用途に対応する貴金属めっき薬品を提供しています。試作から量産までの生産要件に対応可能なめっき薬品および装置を展開しており、多様な化学プロセスに対応するとともに、大口径ウエハや微細構造など、半導体製造の高度化にも柔軟に適応します。

- **CVD/ALD用貴金属プリカーサー**

CVDおよびALDプロセス向けに、主にルテニウム (Ru) 系を中心とした高純度貴金属プリカーサーを開発・供給しています。主には配線層や電極、バリアメタルなどの形成に用いられ、低抵抗かつ高耐久性が求められる先端半導体デバイス構造に対応します。さらに、使用済みプリカーサーや工程内材料のリサイクルにも取り組み、資源利用の効率化に貢献しています。

- **貴金属リサイクル (回収・精製)**

回収・精製から再製造までを一貫して提供するワンストップのリサイクルソリューションを、信頼と高度な技術力を基盤に展開しています。希少で価値の高い貴金属資源の効率的なリサイクルに取り組み、半導体製造における持続可能な供給体制の実現に貢献しています。

【SEMICON Southeast Asia 2026 出展概要】

■展示会名：SEMICON Southeast Asia 2026

■会期：2026年5月5日（火）～7日（木） 9:00～17:00（マレーシア現地時間）

■会場：Malaysia International Trade & Exhibition Centre (MITEC)
(マレーシア・クアラルンプール)

■ブース番号：1521

■主な展示製品：ボンディングワイヤ、銀 (Ag) 接着剤、AgSn TLPシート、
スパッタリングターゲット、プローブピン材料、めっき技術・装置、
CVD/ALD用貴金属プリカーサー、貴金属回収・精製

半導体分野向け田中貴金属製品の詳細は、以下のURLよりご覧いただけます。

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/products/solution/product07.html>

会社情報

■田中貴金属について

田中貴金属は1885年（明治18年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年にわたって、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しています。

2025年度（2025年12月期）の連結売上高は1兆978億円、5,778人の従業員を擁しています。

■田中貴金属 産業用貴金属製品グローバルサイト

<https://tanaka-preciousmetals.com>

■製品問い合わせフォーム

田中貴金属工業株式会社

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/inquiries-on-industrial-products/>

■報道機関お問い合わせ先

・株式会社田中貴金属グループ

サステナビリティ・広報本部 広報・広告部

お問い合わせフォーム

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/inquiries-for-media/>